

NATS-Series

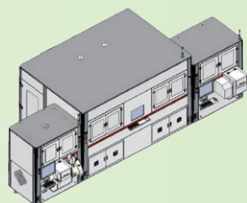
パワー半導体ダイ/デバイス検査システム
Power semiconductor Front-End / Back-End Test System

オートモーティブデバイスの前工程から後工程まで各種検査システムをラインナップ
Power semiconductor Front-End / Back-End Test System

Wafer

Die / Chip

NATS-1302 / 1303



KGD AC/DC Test System

NATS-1302 : DC/AC Test
Multiple Temp Control ~200°C
3 Stage + Liner Handler Type
UPH 1000 chips

NATS-1303 : DC/AC Test
Multiple Temp Control ~200°C
4 Stage + Index Handler Type
UPH 2000 chips

ウェハーからダイ、チップレベルに対応する
各種ハンドラーを取り揃え、高スループット
Applied to Wafer / Die / Chip level and high-through put

DBC / AMB

NATS-1202



DBC/AMB Test System

最大3000A / 1500V

ワイヤボンディング前後のDBCおよびAMBの静的/動的機能検査に対応
Static and dynamic functionality tester for DBC and AMB before/after wire bonding

AQG324 試験規格 Silicon Carbide FET 対応機種 | AQG324 test standard Silicon carbide FET compatible model

Module

NATS-8151 / 8152



Dynamic HTRB HTGB Tester

高温逆バイアス DHTRB / 高温ゲートバイアス DHTGB

広い周波数範囲と柔軟なパラメータ設定に対応するAC/DCテストが可能
Wide range frequency / Flexible setting AC/DC test available

NATS-8153



Dynamic H3TRB Tester

高温高湿逆バイアス Dyn H³TRB

複数レイヤーを個別 / 同時実行を可能とし最小動作単位は1レイヤーから設定可能
Individual / simultaneous execution setting of multiple layers,
and the Minimum operation unit can be set from 1 layer

NATS-8140



Continuous Power Characterizer

連続出力特性検査 | Continuous Power Characterize

CMTI : Max200kV/ μ s
Output Phase Current : 800Arms
Frequency : 1000Hz